



宜鼎國際 (代號:5289) 業績說明會

董事長 簡川勝 2026.08.27

免責說明

本簡報及同時發佈之財務業務訊息及預測性資訊，乃是建立在本公司從內部及外部來源所取得之資訊基礎。本公司未來實際所發生之營運結果及財務狀況可能與這些明示或暗示之預測性資訊有所差異，其原因可能來自於本公司無法掌握之各種風險因素。

本簡報中對未來的展望反映本公司截至目前為止對於未來的看法，對於這些看法，未來若有任何變動或調整時，本公司並不負責隨時提醒或更新。

議程

- 公司簡介與概況
- 市場趨勢與產品策略
- 全球 AI IN ACTION 商務拓展
- ESG 永續承諾
- 財務資訊
- 提問與說明

公司簡介與概況

公司概況



營業額

NT\$ 356.26億元
(2026 1H)

資本額

NT\$9.64億

EPS

NT\$166.45
(2026 1H)

專利數

211

客戶數

4,000+

全球營運佈局



營業地區

25

全球員工

1,259

台灣：1,111 / 海外：148

基地面積
(平方米)

27,000



建築面積：一廠
(平方米)

12,000

建築面積：二廠
(平方米)

15,000



Edge AI 系統與解決方案
Edge AI 嵌入式周邊模組
Edge AI 嵌入式相機模組

2026 產能
(SMT x 6)

1,080K

最大產能
(SMT x 8)

1,440K



宜蘭科學園區
研發製造中心

廠辦空間

合計 5,900 坪

17F 500 坪 / 安提

16F 1,000 坪 / 研發中心、運動活動中心、訓練教室



7F 1,000 坪 / 安提 200 坪

5F 1,000 坪

4F 1,000 坪

3F 1,000 坪

2F 400 坪 / 安提 200 坪

汐止

全球營運總部



產能

1,440K / 最大產能 (SMT x 8)

認證

ISO9001 / ISO14001 / ISO45001 /
QC080000 / ISO14064-1 /
ISO27001 / IEC62443-4-1

廠區

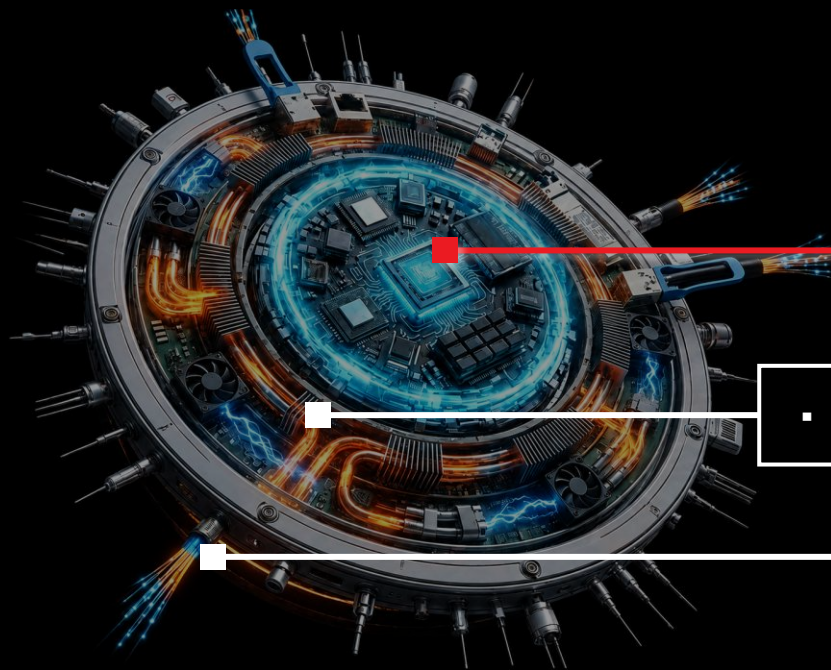
新北市 / 宜蘭縣



核心生產製造理念：品質、永續

市場趨勢與產品策略

AI 發展關鍵核心：運算、記憶體、儲存



innodisk

宜鼎集團全面布局 AI 核心架構

- 運 算：CPU / GPU / NPU / AI ASIC
- 記憶體：記憶體模組 (DRAM Module)
- 儲 存：嵌入式儲存 (Flash Storage)

- 功耗：熱能源管理

- 傳輸：光通訊

宜鼎集團 市場與產品技術佈局 三大核心價值

01

市場與應用產生的價值

AI 加速新一波全球產業變革，重新定義產品、服務與營運的價值創造模式，將產業推向代理式與自主化，全面拓展應用邊界，創造前所未有的產業價值躍升。

02

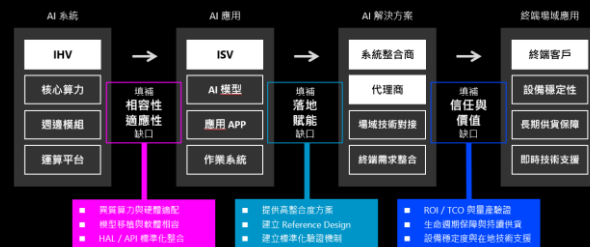
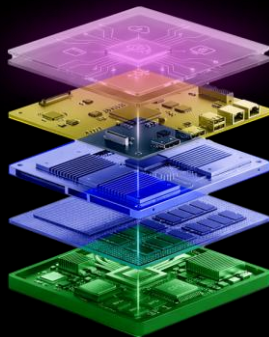
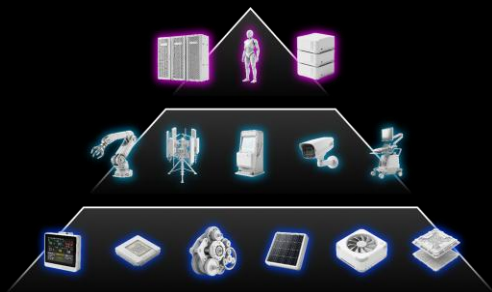
產品技術與人才的價值

專注產品技術與人才發展，宜鼎建構完善的五層 AI 產品技術架構，並在專業人才的實踐下，打造高度相容且協同運作的 AI 解決方案，滿足全球客戶多元的應用需求。

03

Edge AI 快速整合落地的價值

填補技術缺口，憑藉研發實力與全球夥伴關係，建構多元異質核心算力平台及週邊基礎，並結合自主研发的韌體與中介軟體，串聯終端應用，加速邊緣 AI 快速落地。

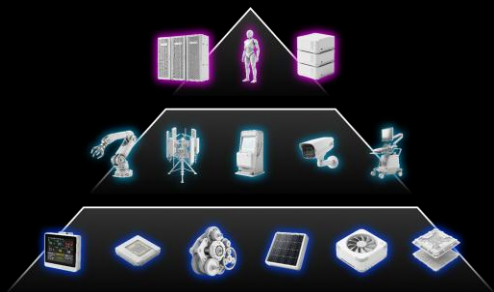


宜鼎集團 市場與產品技術佈局 三大核心價值

01

市場與應用產生的價值

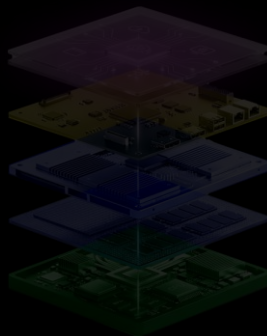
AI 加速新一波全球產業變革，重新定義產品、服務與營運的價值創造模式，將產業推向代理式與自主化，全面拓展應用邊界，創造前所未有的產業價值躍升。



02

產品技術與人才的價值

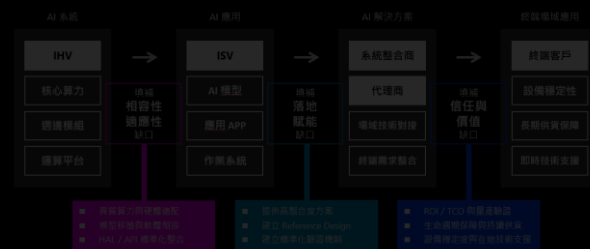
專注產品技術與人才發展，宜鼎建構完善的五層 AI 產品技術架構，並在專業人才的實踐下，打造高度相容且協同運作的 AI 解決方案，滿足全球客戶多元的應用需求。



03

Edge AI 快速整合落地的價值

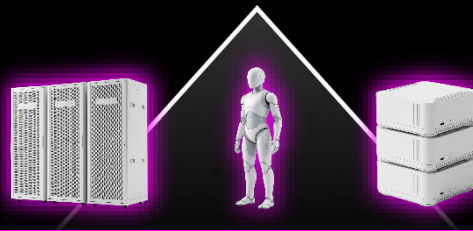
憑藉堅強的技術研發實力與全球夥伴關係，宜鼎建構多元的異質核心算力平台及週邊基礎，並結合自主研發的韌體與中介軟體，串聯終端應用，加速邊緣 AI 快速落地。



01 市場與應用產生的價值

AI 基礎建設

- GPU 伺服器 / 網路交換器 / 路由器
- 人形機器人 / 無人自動化



全球 垂直應用領導品牌

- 醫療保健 / 5G / 安防監控 / 媒體娛樂 / 自動化
- Tier-1 市場領導品牌



高附加價值 工控解決方案供應商

- 製造產業 / 零售物流 / 智慧能源 / 醫療保健 / 網路通訊 / 媒體娛樂 / 企業級應用



01 市場與應用產生的價值

AI 基礎建設



AI 基礎運算、資料與智慧儲存、高速傳輸與規模化部署的核心架構

CSP / 資料中心 / AI 加速運算

AI 訓練與推論規模持續擴張，推升
高效能運算、高頻寬傳輸與大容量
儲存需求，帶動相關產品技術呈現
指數型成長

光通訊 / 網路通訊

AI 資料的傳輸流量高速成長，帶動
低延遲、高頻寬與高可靠傳輸需求；
藉由光通訊與網路通訊建設，將能
支撐 AI 運算需求

機器人 / Physical AI

AI 技術發展，從網路世界走向實體
場域，透過感知、運算與自主決策，
推動機器人與物理 AI 融入人類決策
與日常運作

企業型 AI

企業加速導入生成式 AI 與智慧應用，
將資料轉化為營運洞察與商業成果，
同時兼顧資料隱私、內部治理與營
運效能優化需求

01 市場與應用產生的價值

全球 垂直應用領導品牌



定義市場規格，引領產業應用創新、推動 AI 終端應用走向規模化部署

健康醫療

AI 加速診斷、治療與照護智慧化，
提升醫療精準度與效率，推動先進
醫療設備與服務規模化應用

網通與電信

AI 驅動網路即時分析、智慧調度與
自動化維運，提升連線效能與服務
品質，推動各式即時應用決策

安防監控

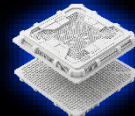
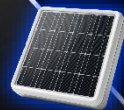
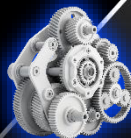
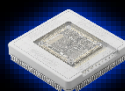
AI 視覺強化即時辨識、事件預警與
決策，讓安防從被動影像紀錄，走
向主動預防，提升公共場域安全性

智慧製造

從自動化走向 AI 製造，不論 AI 影
像辨識或機器人搬運與組裝，AI 正
大規模提升整體生產製造效能

01 市場與應用產生的價值

高附加價值 工控解決方案供應商



深耕多元工控場域，為全球 4,000+ 客戶提供客製整合服務，加速高附加價值 AI 應用落地

深度場域 Know-how

工控應用多元且環境複雜，設備、流程與場域條件大相逕庭，高度仰賴深度產業理解與應用經驗

高度客製整合

設備規格、介面與系統架構高度分散，軟硬體整合彈性與客製能力成為專案落地關鍵

高附加價值

產品差異化與智慧化需求持續提升，AI 與創新技術成為設備升級、強化終端應用競爭力的重要驅動力

長生命週期

工控設備具有長時間驗證測試與長使用週期特性，對產品可靠度、供貨穩定性具有高度要求

宜鼎集團 市場與產品技術佈局 三大核心價值

01

市場與應用產生的價值

AI 加速新一波全球產業變革，重新定義產品、服務與營運的價值創造模式，將產業推向代理式與自主化，全面拓展應用邊界，創造前所未有的產業價值躍升

02

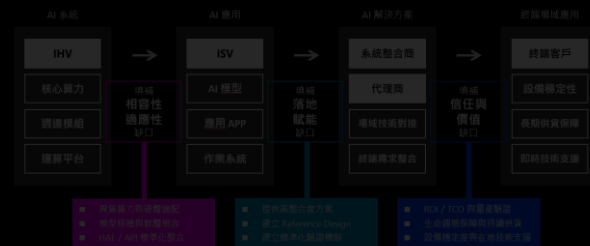
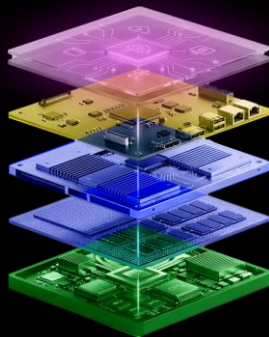
產品技術與人才的價值

專注產品技術與人才發展，宜鼎建構完善的五層 AI 產品技術架構，並在專業人才的實踐下，打造高度相容且協同運作的 AI 解決方案，滿足全球客戶多元的應用需求

03

Edge AI 快速整合落地的價值

憑藉堅強的技術研發實力與全球夥伴關係，宜鼎建構多元的異質核心算力平台及週邊基礎，並結合自主研发的韌體與中介軟體，串聯終端應用，加速邊緣 AI 快速落地



02 產品技術與人才的價值

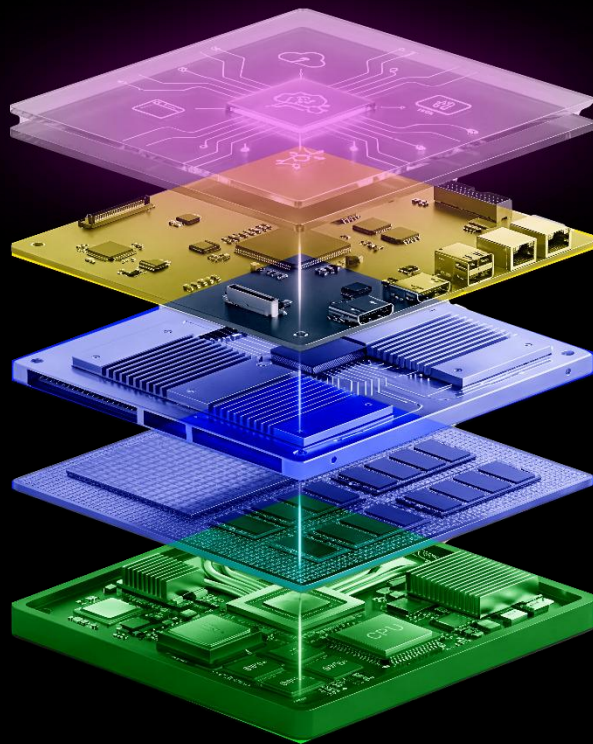
■ Stack 5: 軟體層 (Software)

■ Stack 4: 感測與傳輸層 (Sensing & Comm.)

■ Stack 3: 儲存層 (Storage)

■ Stack 2: 記憶體層 (Memory)

■ Stack 1: 算力層 (Compute)



02 產品技術與人才的價值

五層技術堆疊 × 深耕各層自研產品技術

Stack 5: 軟體層 (Software)

Stack 4: 感測與傳輸層 (Sensing & Comm.)

Stack 3: 儲存層 (Storage)

Stack 2: 記憶體層 (Memory)

Stack 1: 算力層 (Compute)

異質
核心算力

高可靠嵌入式平台、工業級記憶體與高階儲存裝置

工控
模組整合

整合 AI 加速卡、網路卡與影像擷取卡，彈性配置 I/O

客製
系統設計

工業級結構與散熱設計，加速客戶 Time-to-Market

自研
韌體加值

BIOS / BMC / MCU 系統級軟硬體優化與客製服務

快速
場域落地

依場域需求落地，交付完整解決方案

02 產品技術與人才的價值

五層技術堆疊 × 深耕各層自研產品技術

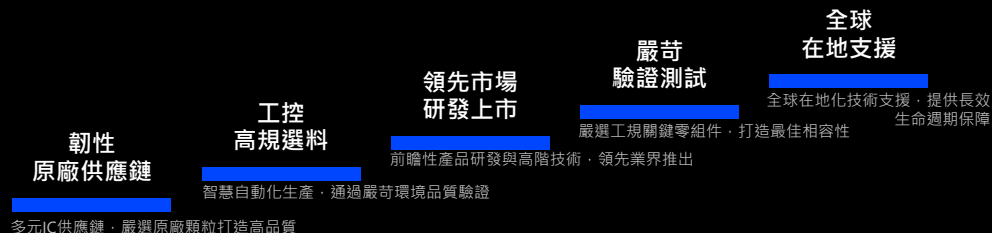
Stack 5: 軟體層 (Software)

Stack 4: 感測與傳輸層 (Sensing & Comm.)

Stack 3: 儲存層 (Storage)

Stack 2: 記憶體層 (Memory)

Stack 1: 算力層 (Compute)



02 產品技術與人才的價值

五層技術堆疊 × 深耕各層自研產品技術

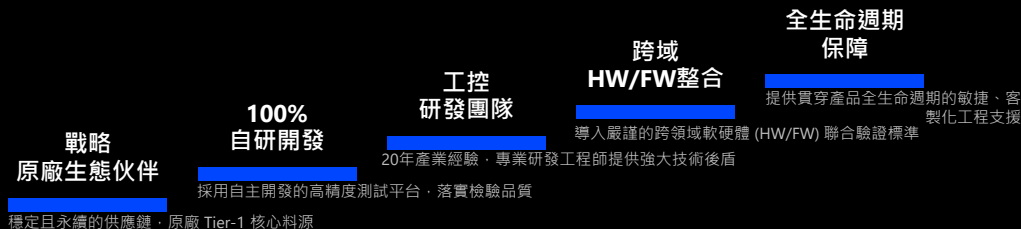
Stack 5: 軟體層 (Software)

Stack 4: 感測與傳輸層 (Sensing & Comm.)

Stack 3: 儲存層 (Storage)

Stack 2: 記憶體層 (Memory)

Stack 1: 算力層 (Compute)



02 產品技術與人才的價值

五層技術堆疊 × 深耕各層自研產品技術

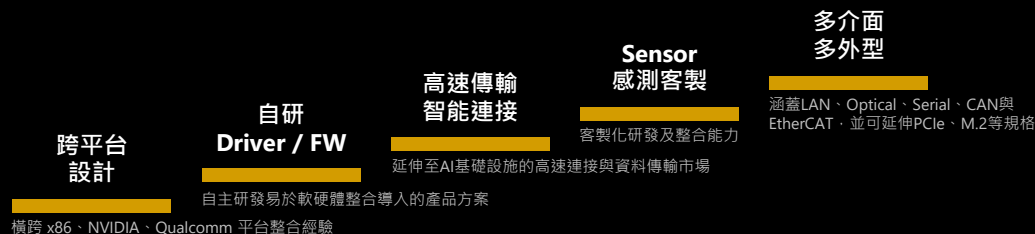
Stack 5: 軟體層 (Software)

Stack 4: 感測與傳輸層 (Sensing & Comm.)

Stack 3: 儲存層 (Storage)

Stack 2: 記憶體層 (Memory)

Stack 1: 算力層 (Compute)



02 產品技術與人才的價值

五層技術堆疊 × 深耕各層自研產品技術

Stack 5: 軟體層 (Software)

Stack 4: 感測與傳輸層 (Sensing & Comm.)

Stack 3: 儲存層 (Storage)

Stack 2: 記憶體層 (Memory)

Stack 1: 算力層 (Compute)

雲端
設備管理

iCAP, OTA, OOB遠端管理

API / SDK
技術支援

API & SDK & Utility 開發與工具套件

BIOS / BSP /
Driver 客製

底層驅動自研客製

模型推論與
訓練工具

iVIT-T & iVIT-I工具套件

AI
Engine

透過MCP 串連Agentic AI

02 產品技術與人才的價值

五層技術堆疊 × 深耕各層自研產品技術

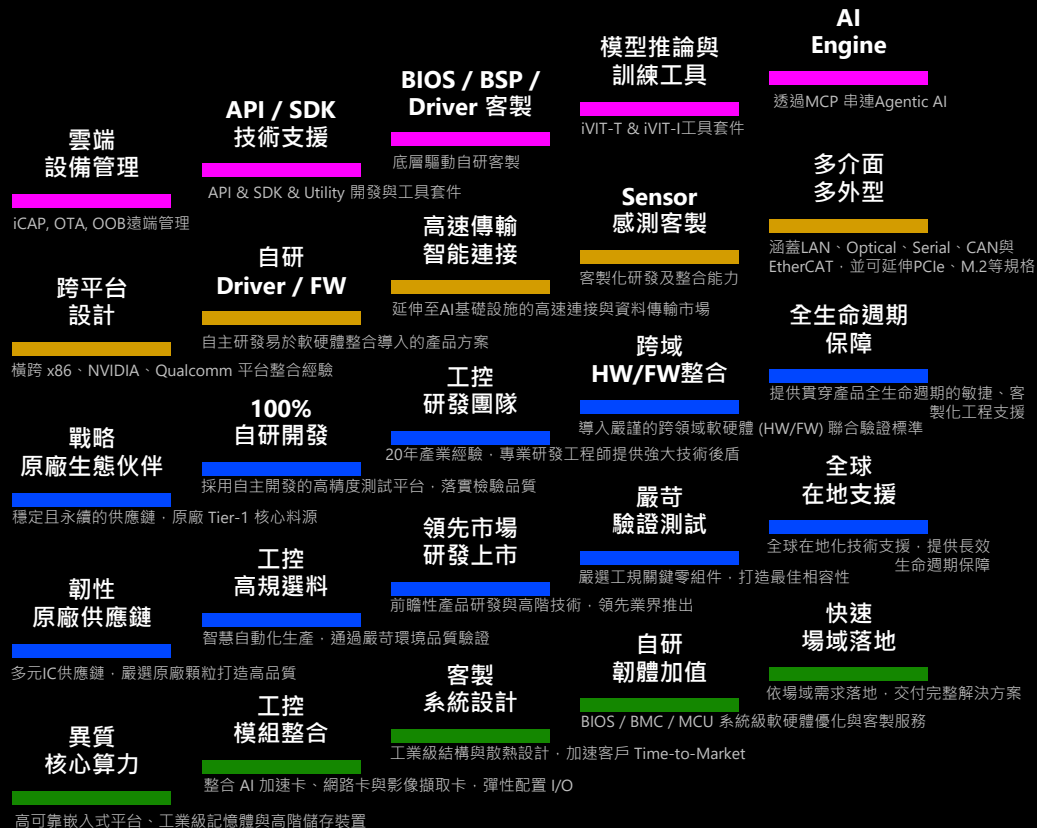
Stack 5: 軟體層 (Software)

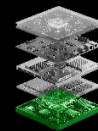
Stack 4: 感測與傳輸層 (Sensing & Comm.)

Stack 3: 儲存層 (Storage)

Stack 2: 記憶體層 (Memory)

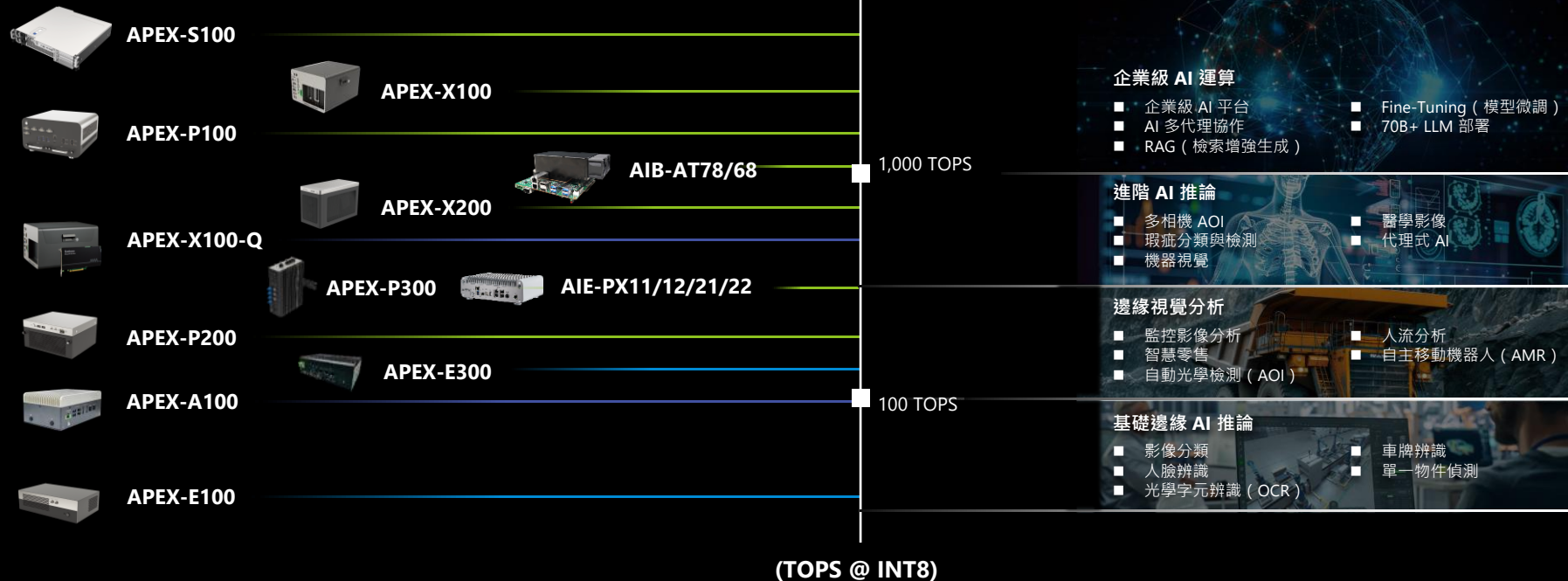
Stack 1: 算力層 (Compute)

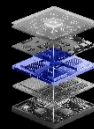




Stack 1: 算力層 (Compute)

Powered by ■ NVIDIA ■ Qualcomm ■ Intel



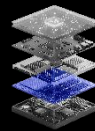


Stack 2 & 3: 記憶體與儲存層 (Memory & Storage)



AI Inference

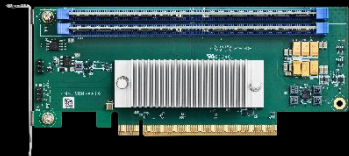
AI Training



Stack 2: 記憶體層 (Memory)

BREAKING AI ARCHITECTURE BOTTLENECKS

CXL AIC (ADD-IN-CARD) 打破 AI 記憶體牆瓶頸



- 目標市場：為 AI 次世代極大化記憶體容量
- 關鍵特點：無縫、大規模記憶體擴充
- 技術優勢：優化超大規模資料中心和 AI 訓練的整體擁有成本

EMPOWERING EDGE AI COMPUTING

DDR5 8000MT/s RDIMM 邊緣 AI 超高速運算引擎



- 目標市場：邊緣 AI 和高速網通頻寬需求
- 效能展現：超低延遲和卓越的穩定性
- 應用領域：即時邊緣推理和海量資料處理

DRAM Module Portfolio

AI Memory



Embedded Memory



Server Memory



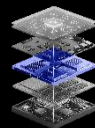
Wide Temp. Memory



Customized Memory



- 規格尺寸：
CMM2 / CUDIMM / CSODIMM / SODIMM / RDIMM / VLP /
- 技術與世代：
CXL / DDR5 / DDR4 / DDR3 / DDR2



Stack 3: 儲存層 (Storage)

PCIe Gen5 & 218-layer 3D NAND Flash

MAXIMIZING SYSTEM BOOT RELIABILITY

資料中心 SSD | 開機碟

PCIe Gen5, 5TS4-P Series: E1.S and U.2



- 優化啟動：高速啟動和高速作業系統載入
- 可靠性：高耐久性，可承受頻繁的資料寫入

ACCELERATING LARGE-SCALE DATA THROUGHPUT

資料中心 SSD | 資料碟

PCIe Gen5, 5TS-P Series: U.2, EDSFF (E3.S, E3.L and E1.S)



- 高吞吐量：專為大規模資料處理設計，展現高效能與穩定性
- 低延遲：高擴展性，滿足繁重的資料處理和儲存需求

Flash Storage (SSD) Portfolio

PCIe



USB



SD



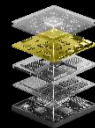
PATA



SATA



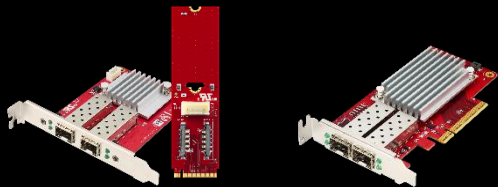
- 規格尺寸與技術：
M.2 / U.2 / CFexpress / EDSFF / 2.5" / 1.8" / SATA Slim /
SATADOM / mSATA / CFast / nanoSSD / CompactFlash Card /
SD Card & MicroSD Card / USB / USB EDC



Stack 4: 感測與傳輸層 (Sensing & Comm.)

REVOLUTIONIZING COMPACT SYSTEM BOOTING

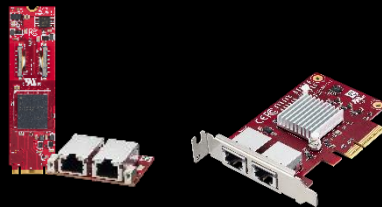
10GbE / 25GbE 光纖網路擴充卡



- 節省空間：全球首款適用於小型機殼的 M.2 SFP+ 網路模組
- 高速傳輸：高速穩定的資料傳輸，提升資料交換效率

ENHANCING HIGH-EFFICIENCY DATA EXCHANGE

10GbE RJ45 LAN 網路擴充卡



- 支援寬溫：全球首款寬溫 10GbE 網路模組
- 優化啟動：即時資料傳輸，滿足高效能應用

Intelligent Peripheral Solution Portfolio

LAN



CAN Bus & CAN FD

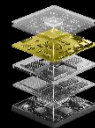


Serial



Wi-Fi





Stack 4: 感測與傳輸層 (Sensing & Comm.)

RUGGEDIZED LONG-RANGE VISION & CLARITY

GMSL2 相機模組系列

高頻寬、長距離、低延遲

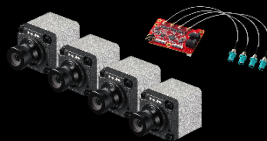


- **IP67/IP69K 防護等級**：達到最高防水防塵標準
- **15 公尺超長傳輸距離**：長距離傳輸依然穩定可靠
- **內建 ISP**：卓越畫質，專業影像控制
- **支援 NVIDIA Jetson 和 Raspberry Pi**：相容主流 AI 運算平台

REDEFINING THE EDGE AI VISION STANDARD

Innodisk 影像解決方案：Bundle Package

無縫整合、快速部署、效能實證



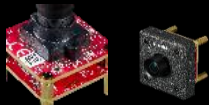
- **整合硬體套件**：GMSL2 攝影機與擷取卡完美搭配，方便快速驗證評估
- **無縫整合**：預先驗證的設計，消除相容性問題
- **加速開發**：專注於視覺軟體開發，快速完成部署
- **卓越效能**：提供清晰畫質與穩定的 GMSL2 訊號品質

Camera Module Portfolio

USB 2.0



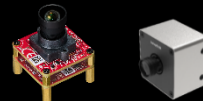
MIPI CSI-2



GMSL2

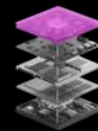


MIPI over Type-C



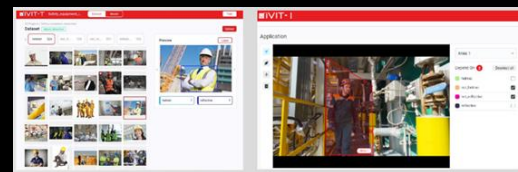
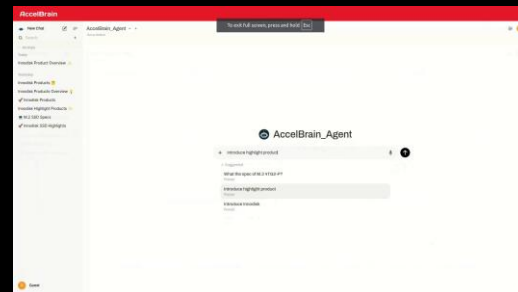
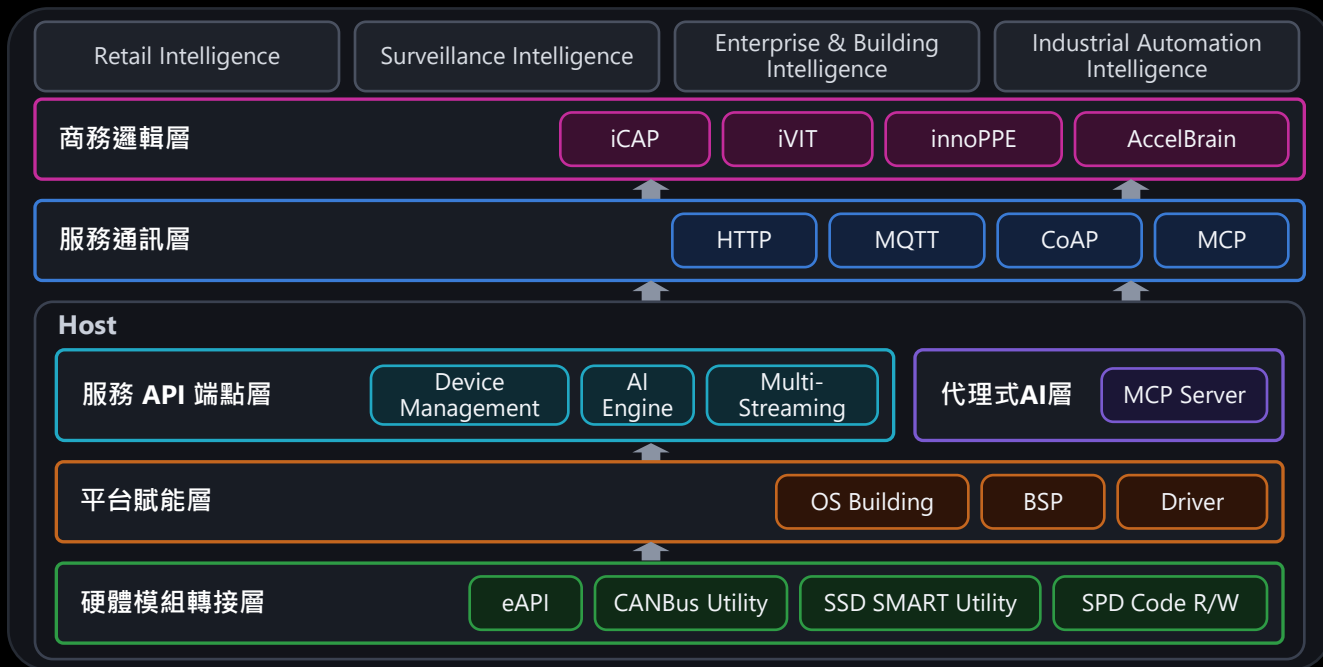
Capture Card





Stack 5: 軟體層 (Software)

堅強軟體研發實力，創造邊緣 AI 附加價值



宜鼎集團 市場與產品技術佈局 三大核心價值

01

市場與應用產生的價值

AI 加速新一波全球產業變革，重新定義產品、服務與營運的價值創造模式，將產業推向代理式與自主化，全面拓展應用邊界，創造前所未有的產業價值躍升

02

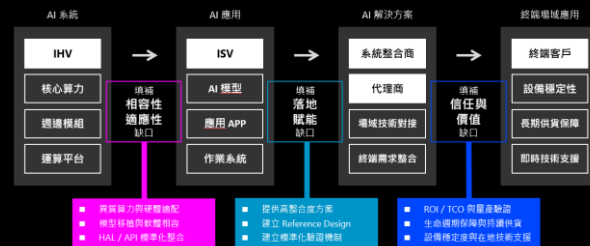
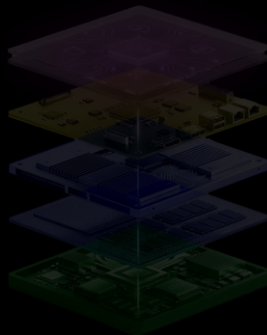
產品技術與人才的價值

專注產品技術與人才發展，宜鼎建構完善的五層 AI 產品技術架構，並在專業人才的實踐下，打造高度相容且協同運作的 AI 解決方案，滿足全球客戶多元的應用需求

03

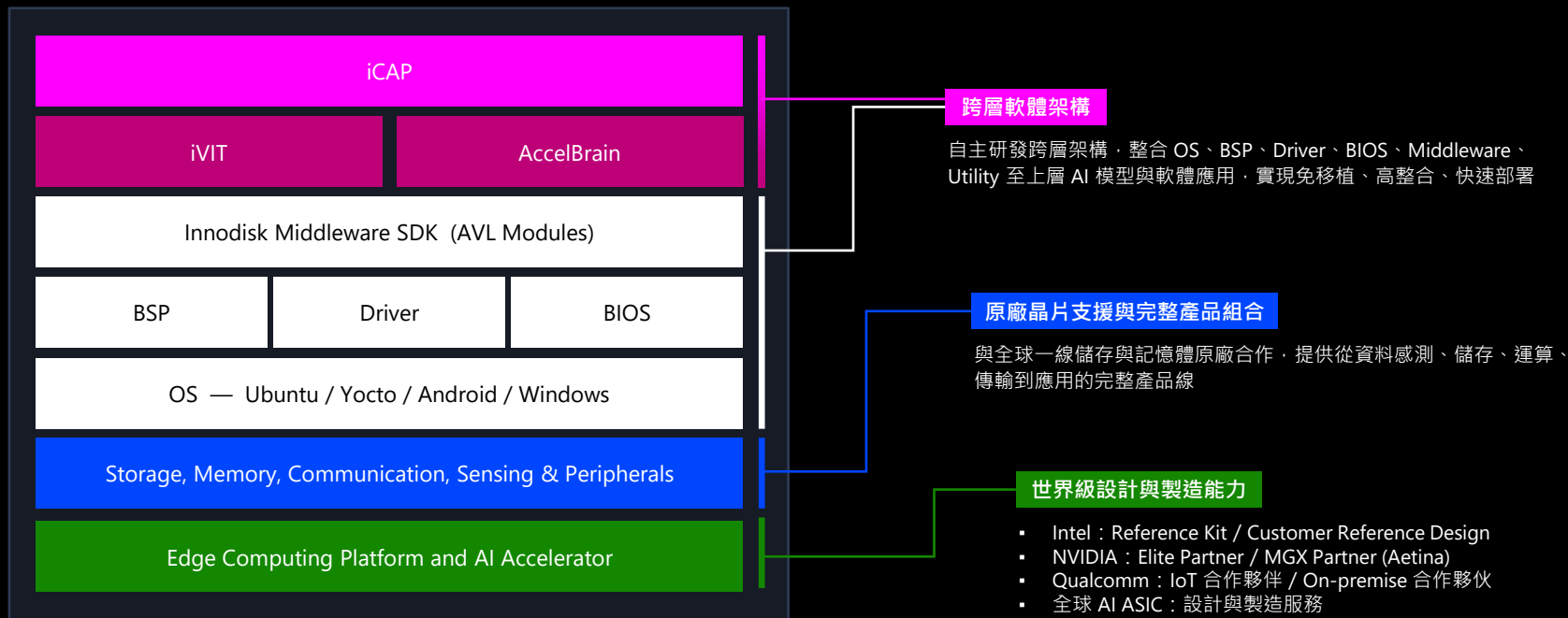
Edge AI 快速整合落地的價值

憑藉堅強的技術研發實力與全球夥伴關係，宜鼎建構多元的異質核心算力平台及週邊基礎，並結合自主研发的韌體與中介軟體，串聯終端應用，加速邊緣 AI 快速落地



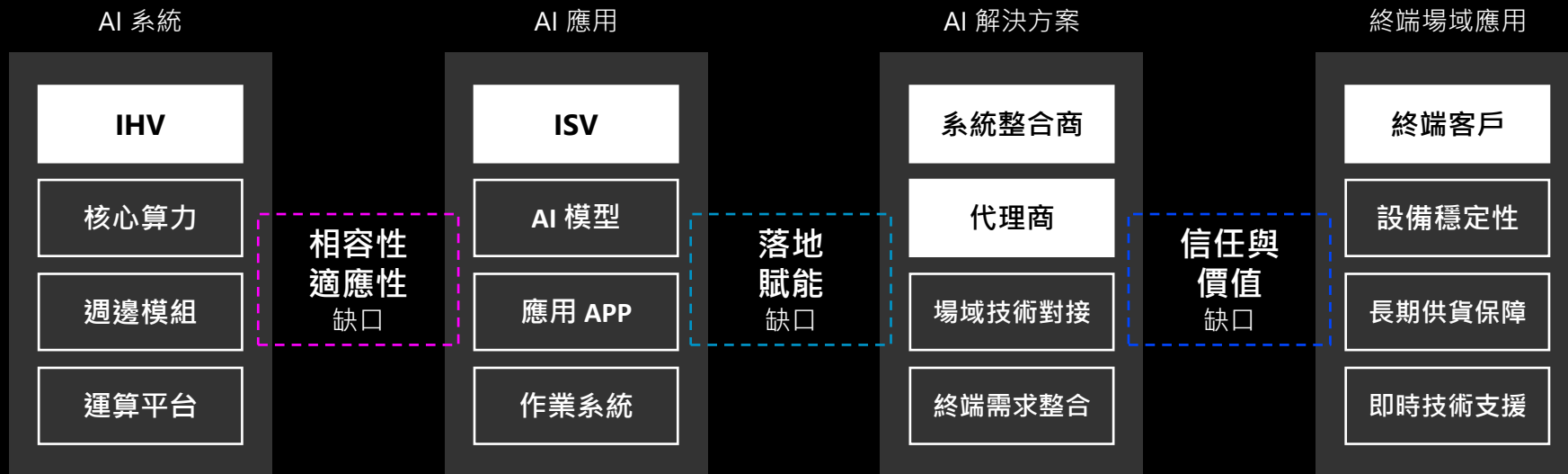
03 Edge AI 快速整合落地的價值

從核心運算到 AI 應用，打造驗證測試與落地部署整合架構



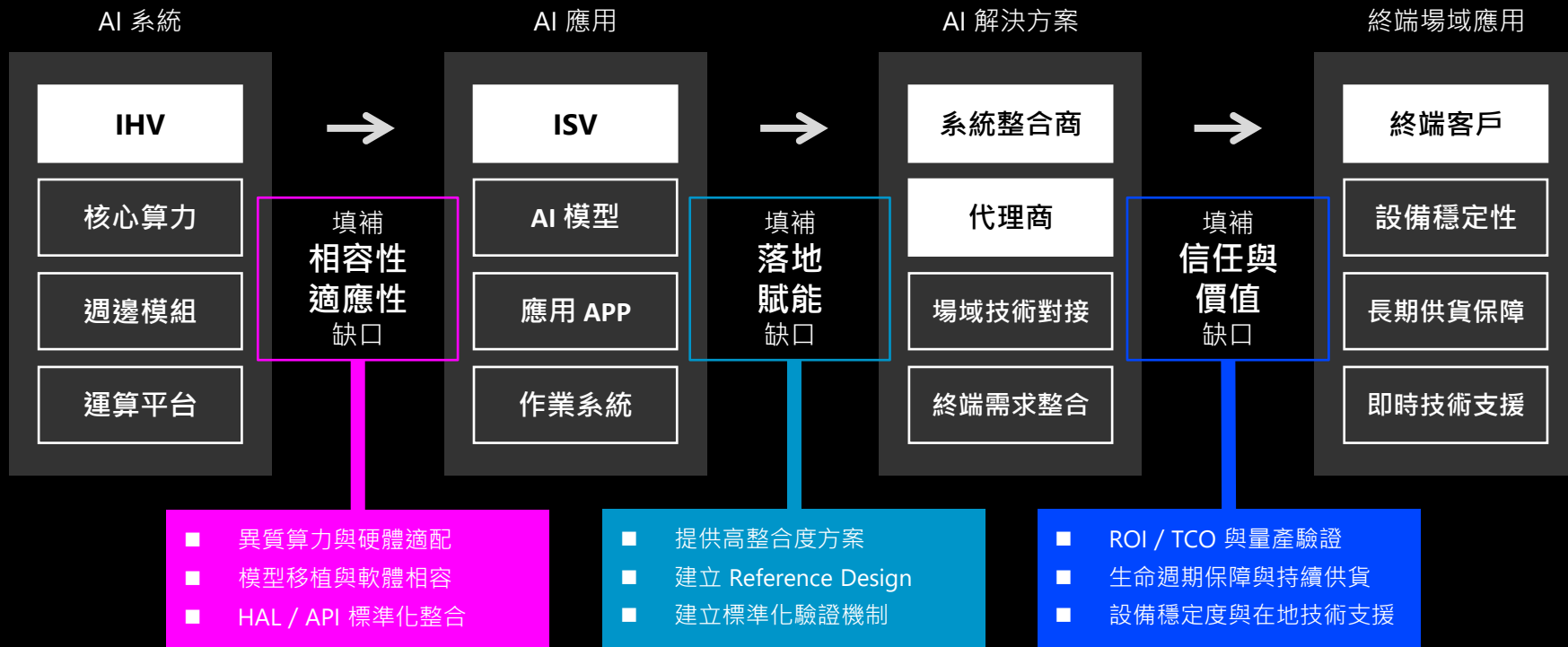
03 Edge AI 快速整合落地的價值

模組化填補技術缺口，分擔客戶端的試錯與技術整合工作



03 Edge AI 快速整合落地的價值

模組化填補技術缺口，分擔客戶端的試錯與技術整合工作





軟體 / 韌體	雲端 AI 平台	iCAP				裝置管理 監測 / OTA / 診斷 推論 & 調教 模型部署 / 訓練 / 優化 執行 & 系統支援 OS 移植 / 執行環境支援 / 預先配置系統 / eAPI 硬體控制 / 軟體設定 資料管理 韌體客製化 / 健康狀態監控 / 加密 & RAID 感測 & 傳輸 視覺輸入 / 資料傳輸 / 即時控制	
	AI-Stack SDK	AccelBrain, AccelTune, IQ Studio, iVIT					
	軟體工具	iSeries Software					
	OS & 中介軟體	Windows, Linux, BSP, eAPI, Drivers					
AI 加速運算	NVIDIA	Intel	Qualcomm	AI ASIC			
AI 平台	x86		ARM				
	Intel Atom x6000 / 7000 Intel 12 / 13 / 14 th Gen Core-i Intel Core Ultra Series1 / 2 / 3 Intel Xeon 6		NVIDIA Jetson Orin / Thor Qualcomm Dragonwing IQ 9 / 8 / X NXP i.MX 8M Plus / 95				
AI 儲存 / 記憶體	Flash						
	DRAM						
AI 周邊模組	Camera			LAN			
	Display			Air Sensor / Gas Sensor	Wireless		
	Storage			CAN Bus / CAN FD	Serial		

01 市場與應用產生的價值

AI 基礎建設

- GPU 伺服器 / 網路交換器 / 路由器
- 人形機器人 / 無人自動化



市場指數成長

全球 垂直應用領導品牌

- 醫療保健 / 5G / 安防監控 / 媒體娛樂 / 自動化
- Tier-1 市場領導品牌



全球應用市場標竿

高附加價值 工控解決方案供應商

- 製造產業 / 零售物流 / 智慧能源 / 醫療保健 / 網路通訊 / 媒體娛樂 / 企業級應用



4,000+ 高附加價值客戶群



一期
2018 (啟用)

二期
2024 (啟用)

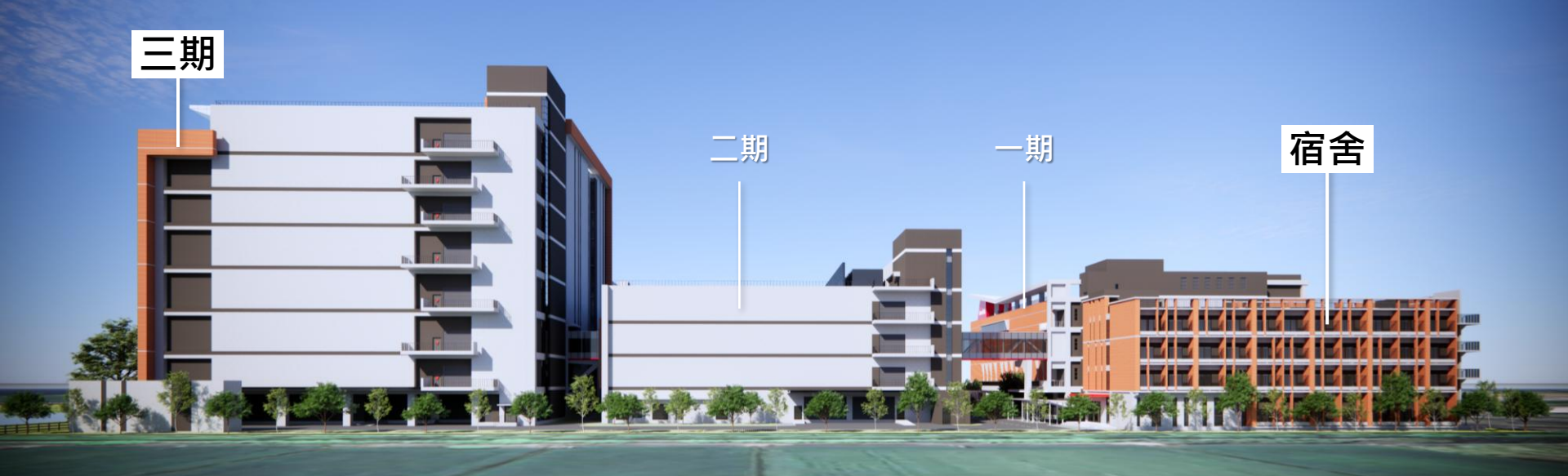
三期
預計 2026 年底動工

宜鼎國際研發製造中心
三期廠房暨宿舍興建工程

宜鼎國際研發製造中心
三期廠房暨宿舍興建工程

預計 2026 年底動工





全球 AI IN ACTION 商務拓展

COMPUTEX 台北國際電腦展 2026

@台灣 台北



INNODISK AI IN ACTION

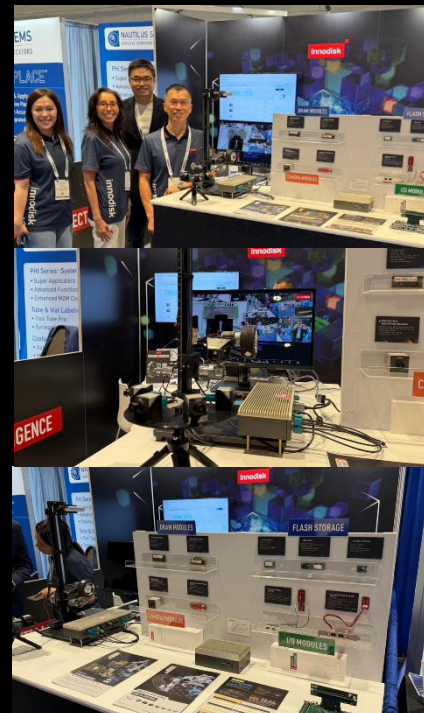
全球邊緣 AI 解決方案拓展



AI EXPO @Taiwan



IT Week @Japan



Automate @USA



Hardware Pioneer Max @United Kindom

ESG 永續承諾

宜鼎永續 亮點成果

- 公司治理評鑑名列 **6~20%** 等級
- 通過董事會核准淨零排放路徑目標，積極邁向淨零轉型的長程方向
- 成立「**永續發展暨資安委員會**」，強化公司在環境、社會、治理與資訊安全面向的整合管理與效率
- 榮獲國際 EcoVadis 銅級及天下永續公民獎、天下人才永續獎、親子天下友善家庭職場獎等多項殊榮，展現宜鼎在永續治理的全方位成果

生態共好 亮點專案

無尾港水鳥保護區：生物多樣性 三年計畫

- 攜手在地團體，投入棲地守護、外來種清除與小燕鷗復育，以實際行動守護生物多樣性環境。
- 透過生態監測與環境教育，結合利害關係人共同構築生物多樣性共榮圈。

岳明國中小：蔚藍行動家培育 三年計畫

- 串聯學界與社區力量，培育未來蔚藍行動家，擴大在地永續發展之社會效益。
- 深入校園推動生態保育教育，透過工作坊、創新提案等，扎根永續素養。

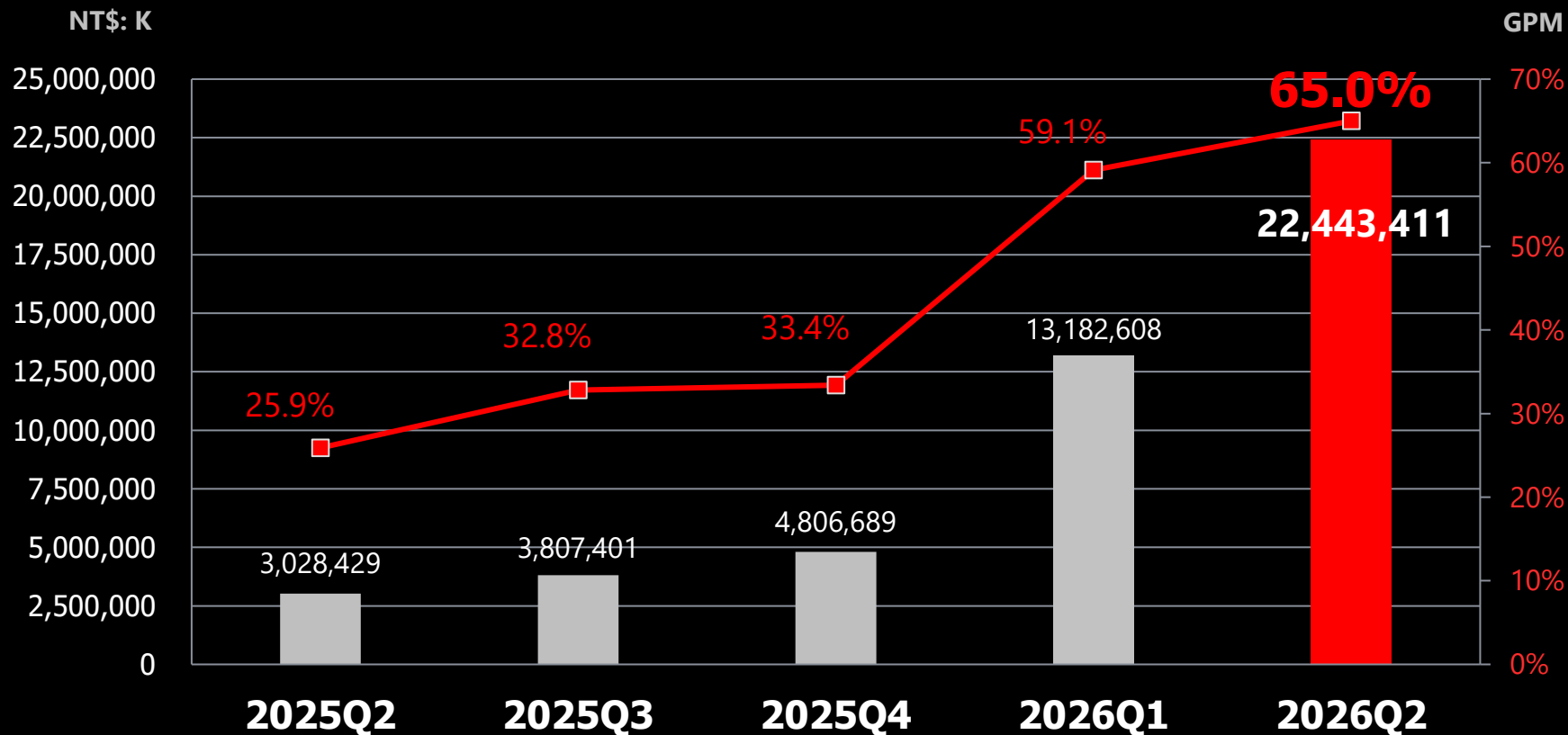


宜鼎國際 永續之路

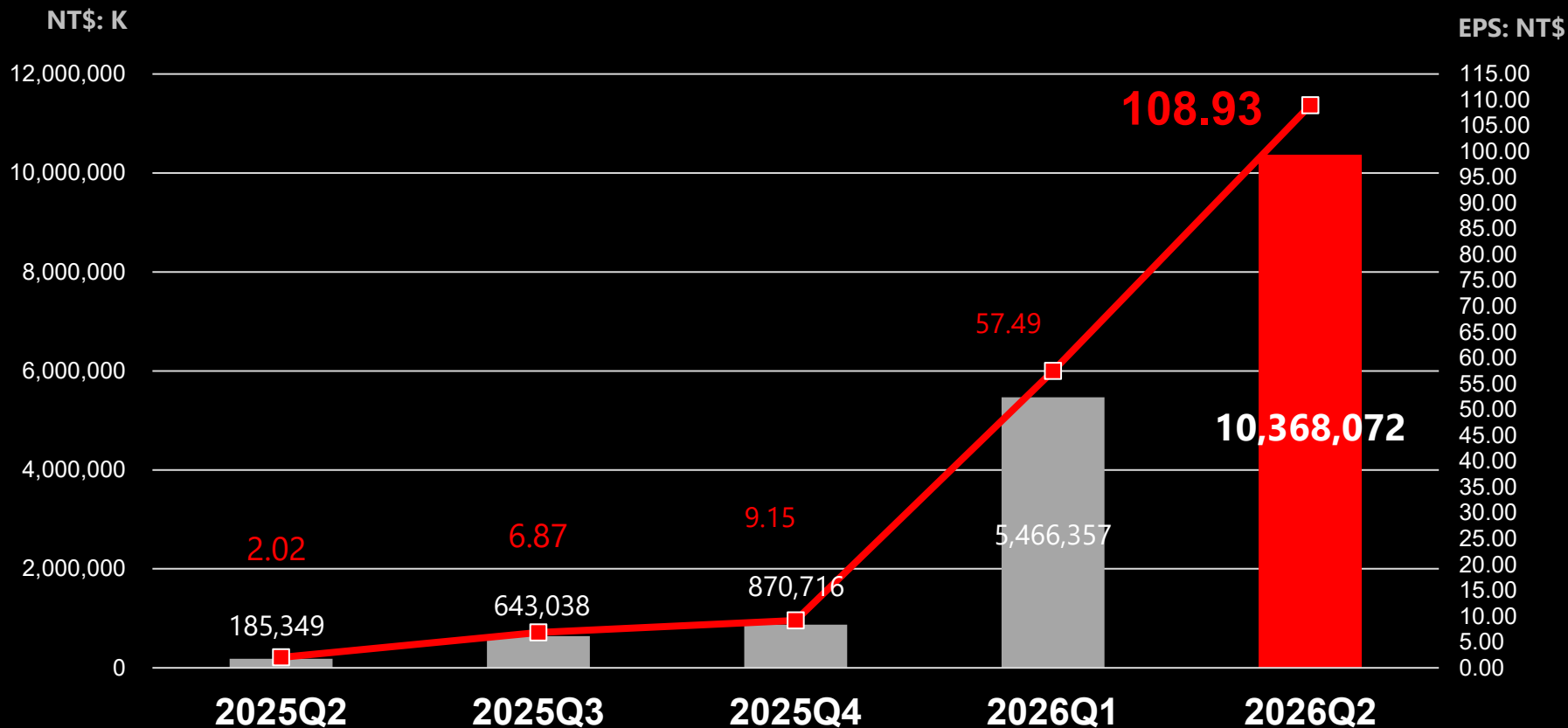


財務資訊

過去 5 季營收與毛利率

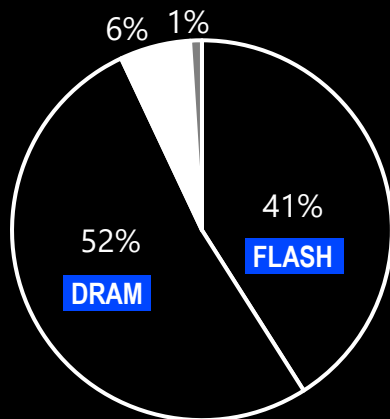


過去 5 季淨利與 EPS

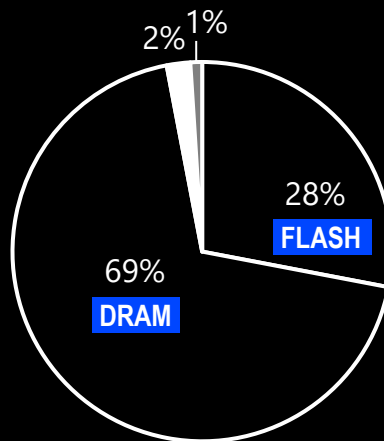


產品營收佔比變化

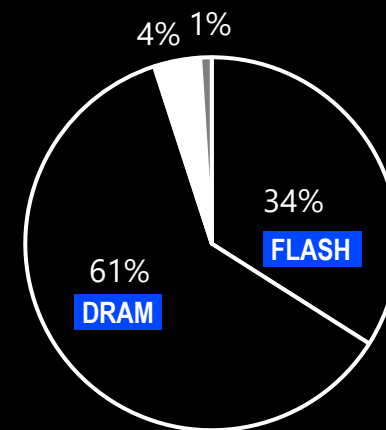
2025Q2



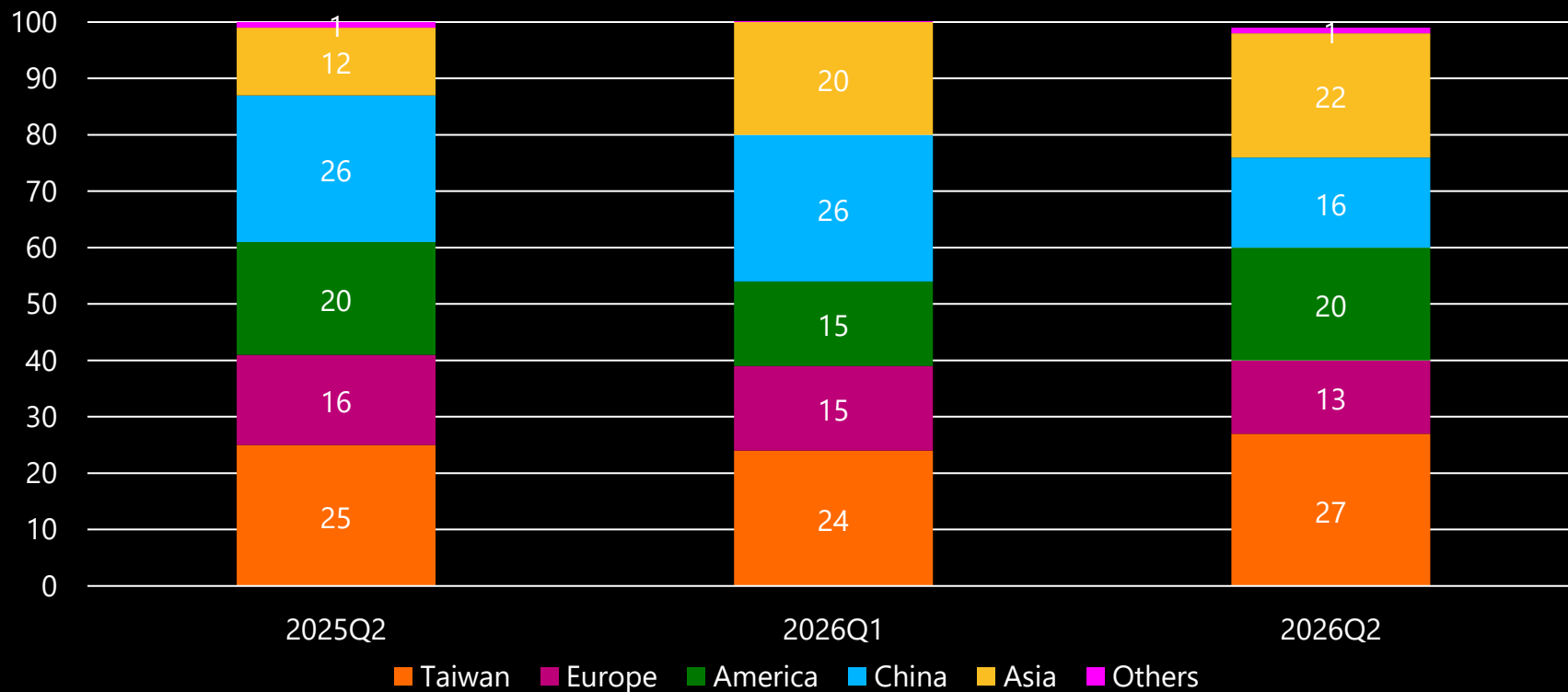
2026Q1



2026Q2

 DRAM FLASH AI Solutions Others

營收依區域佔比



2026Q2 營運成果

	2026Q2	2026Q1	QoQ	2025Q2	YoY
營業收入	22,443,411	13,182,608	70.3%	3,028,429	641.1%
營業成本	7,853,799	5,391,251	45.7%	2,243,340	250.1%
營業毛利	14,589,612	7,791,357	87.3%	785,089	1758.3%
營業費用	1,443,892	941,157	53.4%	431,279	234.8%
營業利益	13,145,720	6,850,200	91.9%	353,810	3615.5%
營業外收入及支出	68,664	66,827	2.7%	-126,311	-154.4%
稅前淨利	13,214,384	6,917,027	91.0%	227,499	5708.5%
所得稅費用	2,808,521	1,439,498	95.1%	53,708	5129.2%
本期淨利	10,405,863	5,477,529	90.0%	173,791	5887.6%
非控制權益利益	37,791	11,172	238.3%	-11,558	-427.0%
歸屬母公司淨利	10,368,072	5,466,357	89.7%	185,349	5493.8%
基本每股盈餘	108.93	57.49		2.02	
毛利率	65.0%	59.1%		25.9%	
營業利益率	58.6%	52.0%		11.7%	
淨利率	46.4%	41.6%		5.7%	

提問與說明

